

## 特点

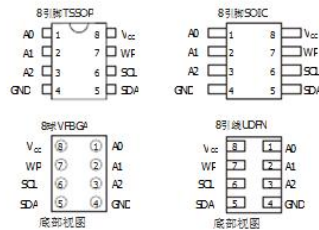
- 低电压和标准电压工作
  - ?  $V_{CC} = 1.7V$  至  $5.5V$
- 内部组织为  $32,768 \times 8$
- 两线串行接口
- 施密特触发器滤波输入抑制噪声
- 双向数据传输协议
- 1兆赫 (  $5.0V$ ,  $2.7V$ ,  $2.5V$  ) 和  $400\text{ kHz}$  (  $1.7V$  ) 的兼容性
- 写保护引脚用于硬件和软件数据保护
- 64字节页写模式 ( 部分页写允许 )
- 自定时写周期 (  $5\text{ ms}$  以下 )
- 高可靠性
  - ? 耐力: 一百万次擦写循环
  - ? 数据保存期: 40岁
- 提供无铅/无卤设备
- 8引脚SOIC JEDEC, 8引脚UDFN, 8引脚TSSOP和8球VFBGA封装
- 模具销售: 晶圆形式, 松饼包到晶圆

## 描述

该AT24C256C提供262144位串行电可擦除和组织成8比特的32768个词语的可编程只读存储器 (EEPROM) 中每一个。该器件的级联功能允许多达8个器件都有一个共同的两线总线。所述装置被用于许多工业和商业优化应用中的低功耗和低电压操作是必不可少的。该器件提供节省空间的8引脚SOIC JEDEC, 8引脚UDFN, 8引脚TSSOP和8球VFBGA封装。此外, 该器件工作于  $1.7V$  至  $5.5V$ 。

表1中。 引脚配置

引脚名称	功能
A0 - A2	地址输入
SDA	串行数据
SCL	串行时钟输入
WP	写保护
GND	地



## 两线制 串行EEPROM

256K (  $32,768 \times 8$  )

## AT24C256C

初步

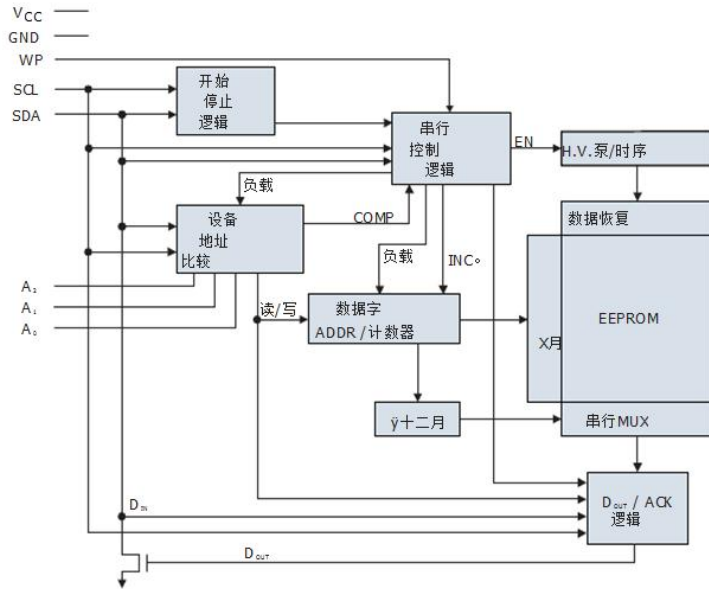
8568A-EEPROM-0/09



## 绝对最大额定值\*

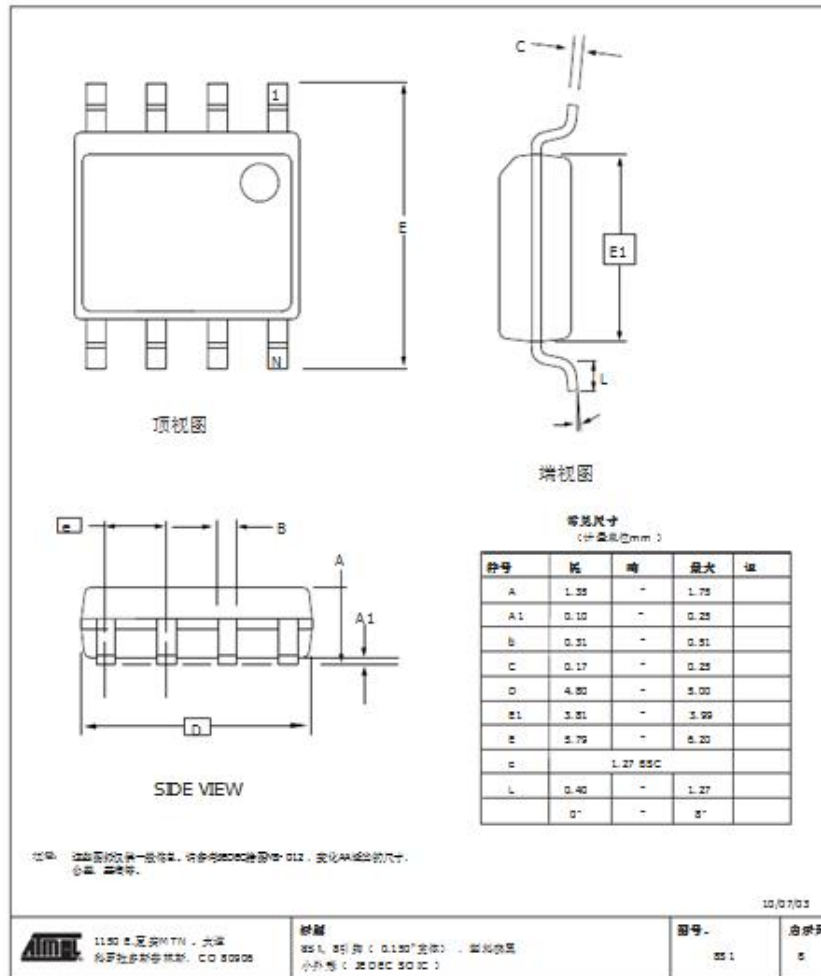
工作温度.....	• $55^{\circ}\text{C}$ 至 $+125^{\circ}\text{C}$
储存温度.....	• $65^{\circ}\text{C}$ 至 $+150^{\circ}\text{C}$
任何引脚电压 相对于地面.....	• $1.0\text{ V} + 7.0\text{V}$
最大工作电压.....	$6.25\text{V}$
直流输出电流.....	$5.0\text{ mA}$

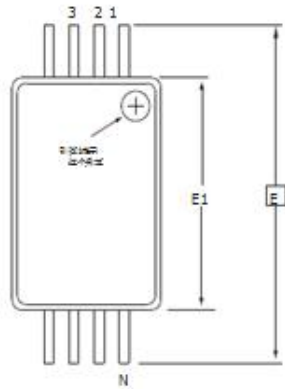
\*注意: 强调超越“绝对下市  
最大额定值”, 可能会造成永久性  
损坏设备。这是一个额定值  
和设备的这些功能操作或  
超越那些标明的任何其他条件  
本规范的业务部门都  
不是暗示。暴露在绝对最大  
额定条件下长时间可能会影响  
器件的可靠性。



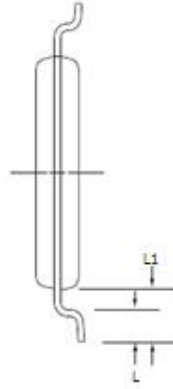
8S1 - JEDEC SOIC

图1. 8S1 - JEDEC SOIC



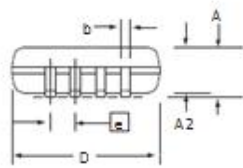


顶视图



端视图

常见尺寸  
(单位: mm)



SIDE VIEW

符号	低	高	最大	注
D	2.90	3.00	3.00	2.5
E	6.40 BSC			
E1	4.30	4.40	4.50	3.5
A	-	-	1.20	
A2	0.80	1.00	1.05	
b	0.19	-	0.30	4
e	0.65 BSC			
L	0.45	0.60	0.75	
L1	1.00参考			

- 注释:
- 1.本图只供一般参考, 详细请参考JEDEC 8 rowing MO-150, 图例AA, 图例A, 图例B, 图例C, 图例D.
  - 2.凡与焊盘接触的 PROT nutions 应涂覆, 其厚度为: 焊盘厚度与焊盘间距的 10% (0.025mm)。
  - 3.凡与焊盘接触的 PROT nutions, 其引线和 PROT nutions 的间距: 0.25mm (0.010") 或更大。
  - 4.凡与焊盘接触的 PROT nutions, 其引线和 PROT nutions 的间距应大于或等于 0.25mm (0.010") 或更大, 其厚度为: 焊盘厚度与焊盘间距的 10% (0.025mm)。
  - 5.凡与焊盘接触的 PROT nutions 在焊盘厚度上, 最小的间距: 0.25mm (0.010") 或更大。

05/30/02



2325 百汇居  
圣何塞, 加利福尼亚 95131

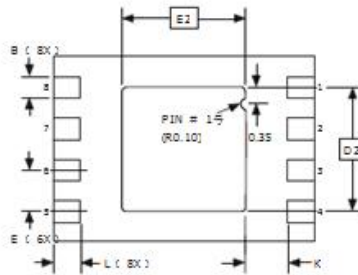
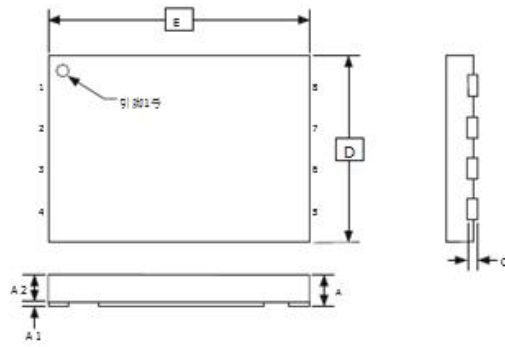
标题  
SA2, 8引脚, 4.4 mm 高度, 塑料  
超薄微型小功率封装 (TSSOP)

图号-

SA2

图号

B



封装尺寸  
(单位: mm)

序号	标	称	最大	注
D		2.00 BSC		
e		3.00 BSC		
D2	1.40	1.50	1.50	
E2	1.20	1.30	1.40	
A	0.50	0.55	0.50	
A1	0.0	0.02	0.05	
A2	-	-	0.25	
C		0.152 R <sub>max</sub>		
L	0.30	0.35	0.40	
b		0.50 BSC		
b	0.15	0.25	0.30	3
K	0.20	-	-	

- Notes: 1. This drawing is for general information only. Refer to JEDEC Drawing MO-229, for proper dimensions, tolerances, datums, etc.  
 2. The terminal #1 ID is a laser-marked feature.  
 3. Dimension b applies to metallized terminal and is measured between 0.15 mm and 0.30 mm from the terminal tip. If the terminal has the optional radius on the other end of the terminal, the dimension should not be measured in that radius area.

4/15/08

封装图纸规范方式:  
package drawings@atmel.com

标题  
BMA2, 8脚, 2 x 3 x 0.6 mm 封装, 热  
焊丝封装 (ULTRA RA 系列) 贴片元件  
引脚封装 (UDFN)

GPC

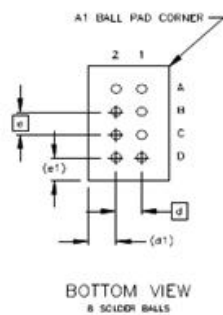
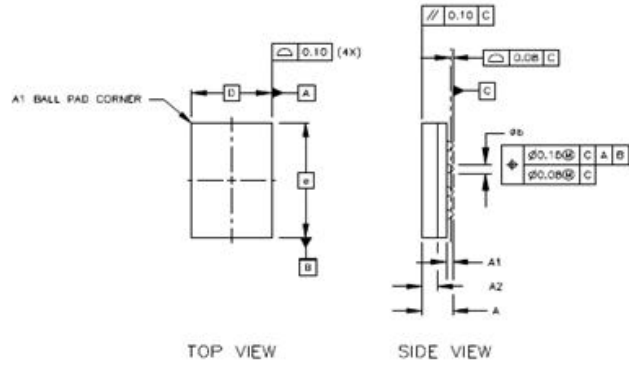
YNZ

图号 -

BMA 2

版次

A



注意事项:  
 1. 公差一按图注。  
 2. 尺寸 B 为测得的最大的球和球半径。  
 3. 锡球成分为 95.5Sn - 40Ag - .5Cu。

参见尺寸  
(单位为毫米)

符号	长	宽	最大	注
A	0.81	0.91	1.00	
A1	0.15	0.20	0.25	
A2	0.40	0.45	0.50	
b	0.25	0.30	0.35	
D	2.35 BSC			
E	3.73 BSC			
e	0.75 BSC			
e1	0.74 REF			
d	0.75 BSC			
d1	0.80 REF			

封装图联系人: packagedrawings@stmc.com

标题  
 8U2-1, 8球, 2.35 X 3.73 毫米机身, 0.75 毫米间距  
 VFBGA封装 (d8GA2)

GPC 图号: REV.  
 GWW 8U2-1 C

2/25/08